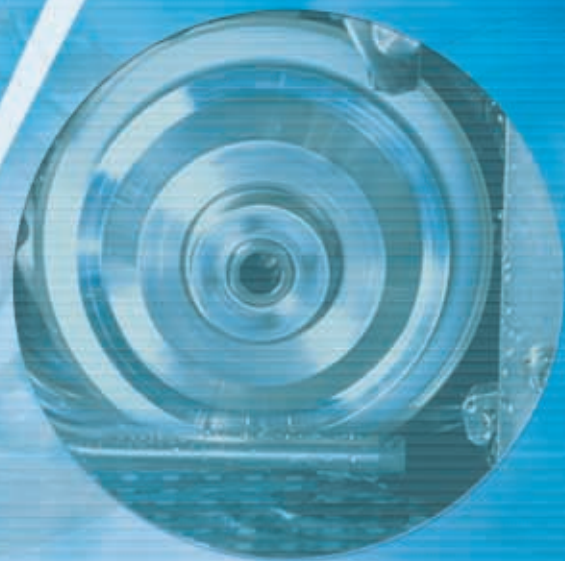


第63期  
事業報告書

平成13年4月1日～平成14年3月31日



disco

ディスコのミッション  
Kiru,Kezuru,Migaku

**ディスコは人類最高の石器人として、  
暮らしの中の快適を創ります。**

はるか古代の遺跡から発掘されたさまざまな石器。穀物の穂を刈り取ったり、あるいは獲物を捕えたであろう それらの素朴な道具は、古代の人びとの生活を偲ばせます。

ところで少し意外かもしれませんが、石器をつくるには、たとえば石を割るときの微妙な角度等、高度な専門技術が必要としたのです。古代の「プロフェッショナル」たちは、人びとの暮らしを支えるために、当時の最高の技術を傾けて石器づくりに励んだのです。

ディスコは、このような石器のストーリーにとっても興味を持っています。ディスコのビジネスのテーマであるKiru・Kezuru・Migakuは、古代の石器に象徴されるように、人類の長い歴史の中で常に、暮らしに欠かせないベーシックな技術でした。そして、もちろん人類の未来においても不可欠なものです。

私たちのミッションは、その技術を高め、遠いところにある最新の科学でさえ、人びとの身近な快適につなげること。そのミッションは、専門技術によってさまざまな利器をつくり、後世に伝統として伝えた石器づくりのプロフェッショナルたちと同じ「思い」を描いているように思えてなりません。

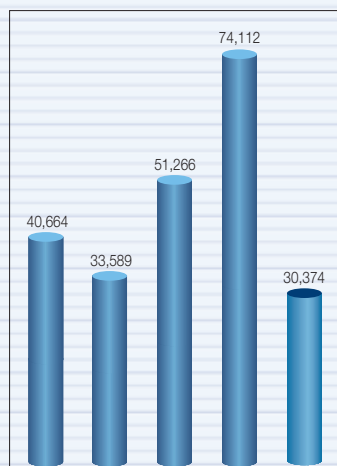
ディスコは現代の石器人。  
人類最高の石器人でありたいと本気で考えています。

## 主要財務数値

(連結)

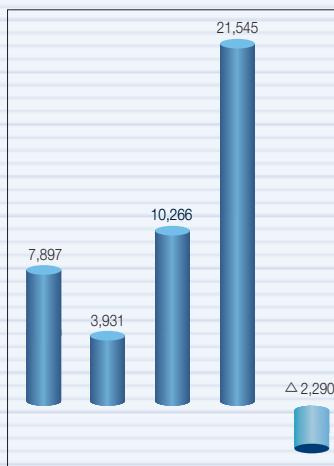
	平成10年3月期 (第59期)	平成11年3月期 (第60期)	平成12年3月期 (第61期)	平成13年3月期 (第62期)	平成14年3月期 (第63期)
売上高(百万円)	40,664	33,589	51,266	74,112	30,374
経常利益(百万円)	7,897	3,931	10,266	21,545	△2,290
当期純利益(百万円)	3,798	2,099	4,871	11,811	△1,795
1株当たり当期純利益(円)	183.49	99.93	230.41	367.76	△55.91
株主資本(百万円)	25,593	27,057	40,845	51,601	49,203
総資産(百万円)	46,893	41,018	67,054	86,435	63,720
株主資本当期純利益率(%)	16.6	8.0	14.3	25.6	△3.6

[売上高(百万円)]



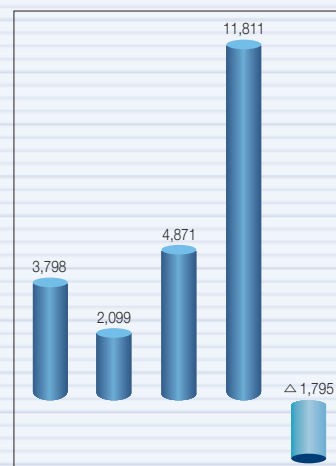
第59期 第60期 第61期 第62期 第63期

[経常利益(百万円)]



第59期 第60期 第61期 第62期 第63期

[当期純利益(百万円)]



第59期 第60期 第61期 第62期 第63期

### 「Kiru, Kezuru, Migaku」(切る、削る、磨く)技術への特化

ディスコは、1937年の創業以来、一貫してさまざまな素材を高い精度で加工する研削切断技術に携わってまいりました。当社のこの「Kiru, Kezuru, Migaku」(切る、削る、磨く)技術は、微細加工の分野を中心として半導体業界、電子部品業界等で広く活用され、高度化、多様化する半導体や電子部品の進展に大きな役割をはたしています。今後とも、「Kiru, Kezuru, Migaku」技術をより一層高め、そこから生まれる世の中の新しい「快適さ、便利さ」を追求していくとともに、当社の存在が長期に亘り世の中で必要とされるために、良質な企業文化の構築に意を注いでいきます。そして株主やお取引先、従業員など当社を取り巻くあらゆるステークホルダーから歓迎されるよう、企業価値の一層の向上を図ることを基本方針としています。

当社は、機械装置、精密ダイヤモンド砥石のハードのみならず、それらの使い方(アプリケーション技術)も含めた三位一体のノウハウを有しており、この分野に特化して技術レベルを絶えず磨き続けてまいりました。当期の主な開発成果としては、研削性能向上やロングライフ化などの高機能化を実現した精密ダイヤモンド砥石の新商品シリーズ「01シリーズ」、ICカードや積層型のパッケージ向けに数十ミクロン単位の薄さの極薄チップを加工するための全自動ドライポリッシャーDFP8140、極薄加工したウェーハを破損することなく安全に搬送できるWSS(ウェーハ・サポート・システム)、従来と比べ大幅に生産性や省スペースを実現したフルオートダイシングソーDFD6340、多種多様な研削材料に対する各種アプリケーション技術等であります。今後とも技術革新の激しいこの分野においてユーザーに対して常に最適なソリューションを提供してまいります。

### 業績について

当期、当社の主な市場である半導体業界、電子部品業界におきましては、一昨年からのいわゆるIT不況の影響により、大幅な生産・在庫調整が行われました。このため、当社が主な顧客としている半導体メーカー、電子部品メーカーは、今年度は業績が低迷し設備投資も大幅に抑制することとなりました。

当社はこのような状況のもとで、積極的かつきめ細かい営業活動を展開いたしました。未曾有の半導体不況の下でユーザーの設備投資削減の流れを覆すにはいたりませんでした。この結果、当連結会計年度は、連結売上高303億74百万



代表取締役社長 溝呂木 斉

円(対前期比59.0%減)と大幅減収となりました。また損益面におきまして各種のコスト削減策を実施しましたが、売上高の減少を補うには至らず、連結営業損失23億40百万円、連結経常損失22億90百万円、連結当期純損失17億95百万円と欠損を計上することとなりました。

## 展望

今後、半導体や電子部品は、さらなるデジタル化やブロードバンド化の進展により、中長期的にはボリューム面での成長に加え、一層の高機能化、小型化の進展、加工素材、加工方法の多様化などの技術革新が進展していくことが見込まれています。

この成長や技術革新が当社にとって大きなビジネスチャンスにつながりますが、当社は、機械装置(ハード)、精密ダイヤモンド砥石(ハード)両方を製造する世界で唯一のメーカーであり、これらを使いこなす技術であるアプリケーション技術(ソフト)を有しているという点で技術的優位に立っています。今後ともこの3つの技術の研究開発を積極的、有機的に進めることにより技術的優位性を堅持するとともに、新たな加工ニーズの開拓により事業の裾野拡大を図ってまいります。

## 配当について

当社は株主に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけており、基本的にはROE(株主資本利益率)を向上させる中で、業績に裏付けられた成果の配分を行う方針であります。具体的には、内部留保とのバランスを考慮しつつ安定的な配当に努めるとともに、業績などに応じて増配等の弾力的な還元策を図ってまいりました。

当期につきましては、未曾有の半導体不況という厳しい経営環境の下、売上高、利益共に前期比大幅減を余儀なくされたことにより、誠に遺憾ながら通期で1株当たり20円(前期は特別配当10円を合わせ1株当たり40円)とさせていただきます。

なお、当期におきましては、役員や従業員の業績向上努力とそれに対する成果配分を株主利益により密接に関連付けることにより、一層の業績向上と株主重視の経営を一段と進める狙いから、当社及び子会社の役員・従業員の一部を対象とするインセンティブプラン(擬似ストックオプション)を導入いたしました。

株主の皆様におかれましては、より一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

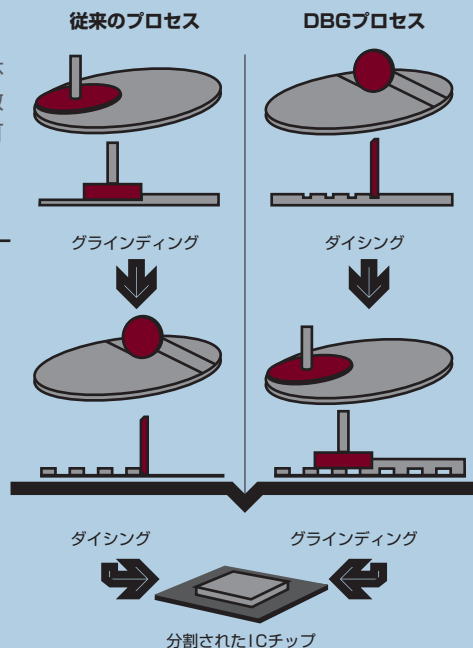
代表取締役社長 溝呂木 斉

ディスコの企業像をさまざまな側面から紹介するDISCO TODAY。ICカードの普及や電子機器の小型化・高機能化を背景として、極薄パッケージや、チップを何層にも積み重ねる積層型パッケージの開発・量産が半導体を巡る大きな技術トレンドの一つとなっており、そのためにはチップを数十マイクロン単位まで薄くする必要があります。今回はチップの極薄化を可能にするDBG（ダイシング・ピフォア・グラインディング）システムと全自動ドライポリリッシャーDFP8140をご紹介します。

## DBGシステム



300mm対応DBGシステム



DBGシステムは、カケや破損を最小限に抑えつつ、ウェーハを0.05mm(50 $\mu$ m)以下に薄く加工することを可能にした技術です。

半導体製造プロセスは、ウェーハと呼ばれる円盤状のシリコンを製造する工程(ウェーハ製造工程)、そのウェーハの上に複雑な数百にも上るICチップを形成する工程(前工程)、そして数百個のICチップを一つ一つに切り分け、組み立て・パッケージング・最終検査をする工程(後工程)からなります。この前工程の最後に、ウェーハの厚みを設計寸法まで薄く削る「グラインディング」があり、後工程の最初にウェーハ上のチップを一つ一つ切り分ける「ダイシング」があります。

通常工程ではダイシングの前にウェーハの厚さが0.2~0.3mm(200~300 $\mu$ m)程度になるまで裏面を研削し、その後個々のチップに切断します(グラインディング→ダイシング)。しかし、この方法ではウェーハの厚みが0.2mm(200 $\mu$ m)を下

回るとダイシング時に大きなソリやウェーハ割れ、裏面のカケなどが発生するため、極薄加工を行う上での大きなネックとなっていました。

DBGは、この順番を逆転させたプロセスです(ダイシング→グラインディング)。まずウェーハを0.05~0.1mm(50~100 $\mu$ m)の切り込み深さまでダイシングソーで溝入れます。その後、ウェーハを裏面からグラインダーで研削します。研削が進んで当初の溝入れ部分まで到達した時点で、ウェーハは個々のチップにきれいに分割されます。

このDBGシステムは、ウェーハの極薄化とチップ分割を同時に行うので、ウェーハ径がより大きくなってもチップの極薄化が可能となります。特に、今後、従来の200mm径のウェーハから300mm径のウェーハが主流となっていくものと見込まれておりますが、こうした大口径ウェーハの極薄加工には最適なシステムです。

# 全自動ドライポリッシャー DFP8140



20 $\mu$ mまで薄削りしたウェーハ



DFP8140で使用される  
研磨ホイール

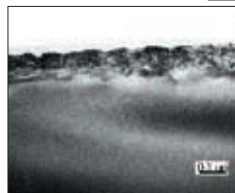
ディスコでは、グラインダーやDBGシステムでの極薄研削の際、チップに与えられる機械的ダメージを除去して0.1mm (100 $\mu$ m)以下の極薄チップの強度を向上させ、チップ積層の際に問題となるチップ反り等を大幅に低減するドライポリッシュ工法を完成させました。

写真Aは厚さ20 $\mu$ mまで薄削りした極薄ウェーハですが、裏面に研削歪みがあると、チップに切り分けた後、そこを原因として反りや割れが発生する可能性が高くなります。ドライポリッシュ工法は、ダイヤモンドではなく酸化金属砥粒を使用した研磨ホイール(写真B)を使用し、ダイヤモンド加工による研削歪みを除去します(写真C,D)。薬液を一切使用しない完全な乾式研磨方式(ドライポリッシュ)を採用したことにより、ローコストな加工が可能となり、また環境に対する負荷を大きく低減することが出来ます。装置と砥石の両方を製造開発するディスコ独自の技術です。

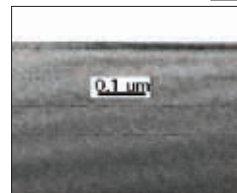
DFP8140(写真E)は、このドライポリッシングに対応した研磨装置で、他のディスコ製品との互換性も考慮した設計となっています。

ディスコのMigaku(磨く)技術による新製品です。

ドライポリッシュ前

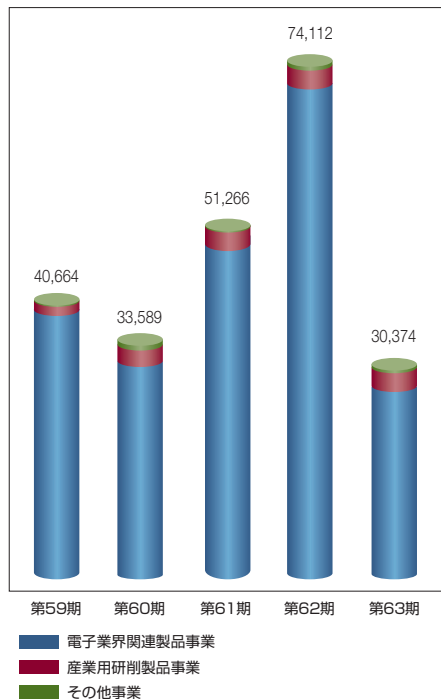


ドライポリッシュ後



ドライポリッシュによる研削歪みの除去

[部門別売上高推移 (百万円)]



ダイシングソー



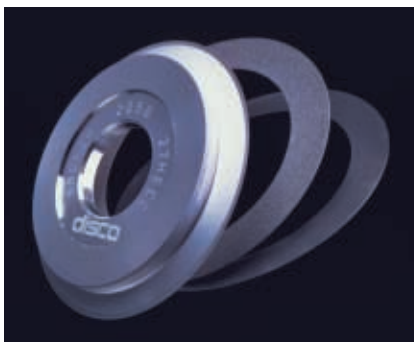
## 電子業界関連製品事業

電子業界関連製品部門は、当社主力製品であるダイシングソー、サーフェスグラインダー、カッティングソー、精密ダイヤモンド砥石、精密電子部品等の製造・販売を行っています。

半導体業界、電子部品業界におきましては、IT化、ブロードバンド化の進展を睨んで部品の高速・大容量化、低消費電力化、微細化などの技術革新は着実に進んでいくものと予想されます。これに伴い、ウェーハの極薄化、高平坦化のための製品・加工技術、各種の新たなパッケージング技術、化合物半導体などに代表される多彩な新材料向け加工・製品技術、製造装置の一層の生産性向上・ローコスト化等、当社の「Kiru, Kezuru, Migaku」(切る、削る、磨く) 技術へのニーズもますます高度化、多様化してきており、この傾向は不況期におきましても変わりはありません。

当期は、一昨年後半からのIT不況により、当社の主要顧客である半導体メーカー、電子部品メーカーの業績が低迷し、設備投資も大幅に抑制されました。当社もこの影響を受け、半導体メーカー、電子部品メーカーによる設備投資の削減と生産稼働率の大幅低下により、ダイシングソー、グラインダーなどの機械装置や精密ダイヤモンド砥石の受注が前期比大幅に減少いたしました。特に機械装置の受注の減少が大きく、受注高、売上高ともに下期が上期をさらに下回るという結果となりました。半導体メーカーや電子部品メーカーの生産の稼働状況を反映する精密ダイヤモンド砥石の受注高・売上高は、概ね第2四半期(7~9月)を底に回復に転じましたが、機械装置の大幅な減少を補えませんでした。この結果、当部門の売上高は、前期比61.4%減の272億3百万円となりました。

地域別には、当事業は半導体メーカー、電子部品メーカーの設備投資削減の影響を受け、国内、北米、アジア、ヨーロッパの全地域に



精密ダイヤモンド砥石

において売上高が減少しました。特に、前期において大幅に売上高を伸ばしたアジア地域の落ち込みが顕著でした。

直近の状況を見ますと、米国経済の回復やアジア諸国の製造業の生産回復などを背景に、パソコンや携帯電話などの最終製品や半導体・電子部品の在庫調整が終了し、当社のユーザーにつきましても、特に当期の落ち込みの激しかったアジア地域のユーザーをはじめとして生産稼働率の上昇や設備投資計画の増額修正の動きもでてきております。こうした背景から、当事業は2002年度下半期を中心に増収を期待しております。

## 産業用研削製品事業

当部門は、ダイヤモンドホイール、研削切断砥石等、主として建築・土木業界向けの研削切断工具の製造・販売を行っています。

当期は、公共事業が前期対比で抑制基調で推移する中、販売活動に努めた結果、売上高は前期比4.2%増の28億74百万円となりました。

また、当事業を独立企業体として利益責任を持たせ、より経営の効率化を進めるため、分社化しました。平成13年10月1日より新会社(株)ディスコ アブレイシブ システムズとして事業を開始しております。

## その他事業

当社のその他事業では、半導体製造装置メーカーなど向けにコンピュータシステムのソフトウェアの開発・販売を行っています。

当事業においては、前期まで連結対象子会社であった天然石材事業を行っている子会社が連結対象からはずれたため(平成13年7月に第三者に出資持ち分の大半を売却)、売上高は前期比62.8%減の2億96百万円となりました。



産業ダイヤモンド砥石

# 財務諸表(連結)

## 連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	第62期	第63期
	(平成13年3月31日現在)	(平成14年3月31日現在)
<b>(資産の部)</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	18,891	7,762
受取手形及び売掛金	21,092	8,526
有価証券	—	20
棚卸資産	19,279	18,561
その他	2,566	2,255
流動資産合計	61,829	37,126
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物及び構築物	8,661	8,863
機械装置及び運搬具	3,486	3,096
土地	5,707	5,720
その他	1,454	1,857
有形固定資産合計	19,311	19,538
<b>無形固定資産</b>		
投資その他の資産	1,116	953
投資有価証券	1,664	1,345
その他	2,512	4,755
投資その他の資産合計	4,177	6,101
固定資産合計	24,605	26,693
資産合計	86,435	63,720
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形及び買掛金	14,251	2,077
短期借入金	2,874	5,473
一年内償還予定の社債	500	—
未払法人税等	7,223	675
その他	7,439	2,740
流動負債合計	32,289	10,967
<b>固定負債</b>		
新株引受権付社債	—	312
長期借入金	—	733
退職給付引当金	1,661	1,529
その他	831	919
固定負債合計	2,493	3,494
負債合計	34,782	14,462
<b>(少数株主持分)</b>		
少数株主持分	51	54
<b>(資本の部)</b>		
資本金	9,770	9,770
資本準備金	10,637	10,637
連結剰余金	31,472	28,794
その他有価証券評価差額金	31	57
為替換算調整勘定	△310	△51
自己株式	△0	△4
資本合計	51,601	49,203
負債、少数株主持分及び資本合計	86,435	63,720

## 連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	第62期	第63期
	(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
売上高	74,112	30,374
売上原価	35,665	17,781
販売費及び一般管理費	17,453	14,932
営業利益	20,993	△2,340
営業外収益	1,040	471
営業外費用	487	422
経常利益	21,545	△2,290
特別利益	76	90
特別損失	1,009	632
税金等調整前当期純利益	20,613	△2,833
法人税、住民税及び事業税	9,236	370
過年度法人税等戻入額	—	581
法人税等調整額	△434	△801
少数株主損失	—	24
当期純利益	11,811	△1,795

## 連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(単位:百万円)

科 目	第62期	第63期
	(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	8,758	△7,655
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,067	△6,025
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,068	2,455
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	348	97
V 現金及び現金同等物の増加額	971	△11,128
VI 現金及び現金同等物の期首残高	17,920	18,891
VII 現金及び現金同等物の期末残高	18,891	7,762

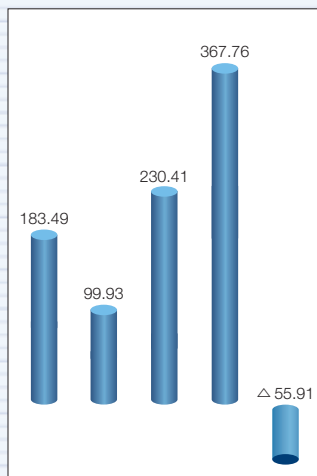
## 連結剰余金計算書

(単位:百万円)

科 目	第62期	第63期
	(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
連結剰余金期首残高	20,438	31,472
連結剰余金増加高	—	320
連結除外による増加額	—	320
連結剰余金減少額	777	1,203
配当金	695	1,124
役員賞与	81	79
当期純利益	11,811	△1,795
連結剰余金期末残高	31,472	28,794

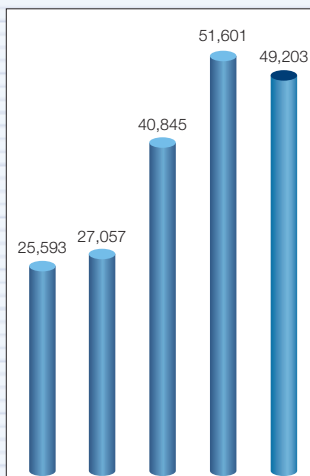
# 業績の推移(連結)

【一株当たり当期純利益(円)】



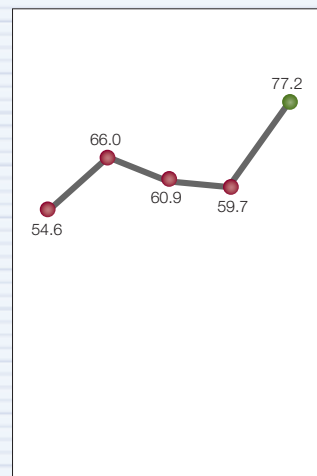
第59期 第60期 第61期 第62期 第63期

【株主資本(百万円)】



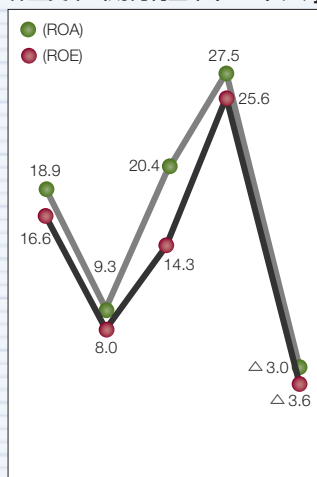
第59期 第60期 第61期 第62期 第63期

【株主資本比率(%)】



第59期 第60期 第61期 第62期 第63期

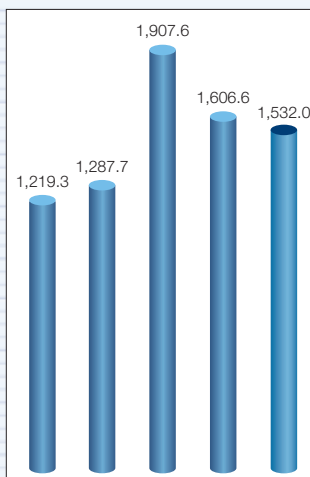
【総資産事業利益率(ROA) / 株主資本当期純利益率(ROE) (%)】



第59期 第60期 第61期 第62期 第63期

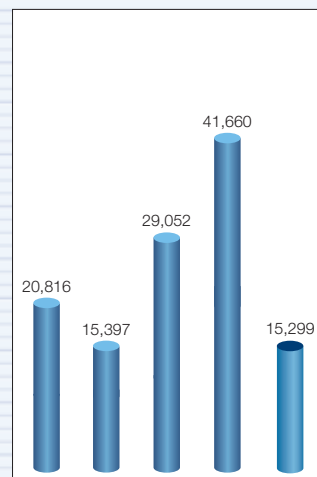
(注) 事業利益 = 営業利益 + 受取配当金 + 受取利息

【一株当たり株主資本(円)】



第59期 第60期 第61期 第62期 第63期

【海外売上高(百万円)】



第59期 第60期 第61期 第62期 第63期

## 財務諸表(単独)

### 貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	第62期	第63期
	(平成13年3月31日現在)	(平成14年3月31日現在)
<b>(資産の部)</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	15,493	4,442
受取手形	2,333	462
売掛金	12,965	4,992
有価証券	—	20
棚卸資産	16,015	15,479
その他	4,057	5,407
<b>流動資産合計</b>	<b>50,865</b>	<b>30,805</b>
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物及び構築物	7,806	7,292
機械及び装置	2,807	2,758
土地	4,983	4,983
その他	1,069	1,794
<b>有形固定資産合計</b>	<b>16,666</b>	<b>16,829</b>
<b>無形固定資産</b>		
	819	687
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	1,157	861
関係会社株式	2,321	2,835
その他	2,399	4,148
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>5,879</b>	<b>7,845</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>23,365</b>	<b>25,362</b>
<b>資産合計</b>	<b>74,230</b>	<b>56,168</b>
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	5,715	837
買掛金	5,899	528
短期借入金	—	3,000
一年内償還予定の社債	500	—
未払金	3,806	843
未払法人税等	5,261	39
その他	2,119	1,000
<b>流動負債合計</b>	<b>23,302</b>	<b>6,249</b>
<b>固定負債</b>		
新株引受権付社債	—	312
退職給付引当金	1,491	1,353
その他	787	844
<b>固定負債合計</b>	<b>2,278</b>	<b>2,510</b>
<b>負債合計</b>	<b>25,580</b>	<b>8,759</b>
<b>(資本の部)</b>		
<b>資本金</b>		
	9,770	9,770
<b>法定準備金</b>		
	11,146	11,231
<b>剰余金</b>		
	27,701	26,353
(うち当期純利益)	(9,201)	(△83)
その他有価証券評価差額金	31	57
自己株式	—	△4
<b>資本合計</b>	<b>48,649</b>	<b>47,408</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>74,230</b>	<b>56,168</b>

### 損益計算書

(単位:百万円)

科 目	第62期	第63期
	(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
<b>売上高</b>	<b>57,465</b>	<b>19,349</b>
売上原価	27,571	11,124
販売費及び一般管理費	14,278	11,410
<b>営業利益</b>	<b>15,615</b>	<b>△3,185</b>
営業外収益	1,992	2,852
営業外費用	196	126
<b>経常利益</b>	<b>17,411</b>	<b>△459</b>
特別利益	40	15
特別損失	2,156	607
<b>税引前当期純利益</b>	<b>15,294</b>	<b>△1,051</b>
法人税、住民税及び事業税	6,956	127
過年度法人税等戻入額	—	574
法人税等調整額	△863	△520
<b>当期純利益</b>	<b>9,201</b>	<b>△83</b>
前期繰越利益	6,986	9,721
中間配当額	481	321
中間配当に伴う利益準備金積立額	48	—
<b>当期末処分利益</b>	<b>15,658</b>	<b>9,316</b>

### 利益処分

(単位:百万円)

科 目	第62期	第63期
	(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
<b>当期末処分利益</b>	<b>15,658</b>	<b>9,316</b>
任意積立金取崩高	6	5
買換資産圧縮積立金取崩高	5	5
国庫補助金等圧縮積立金取崩高	0	0
<b>合計</b>	<b>15,664</b>	<b>9,322</b>
<b>利益処分額</b>	<b>5,942</b>	<b>321</b>
利益準備金	85	—
配当金	802	321
取締役賞与金	54	—
別途積立金	5,000	—
<b>次期繰越利益</b>	<b>9,721</b>	<b>9,000</b>

- ◎ **社名**  
株式会社ディスコ  
DISCO CORPORATION
- ◎ **本店所在地**  
東京都大田区東糀谷二丁目14番3号
- ◎ **創業年月日**  
1937年5月5日
- ◎ **設立年月日**  
1940年3月2日
- ◎ **資本金**(2002年3月31日現在)  
9,770百万円(32,117,125株)  
東京証券取引所市場第一部  
証券コード6146
- ◎ **従業員**  
1,040名(2002年3月31日現在)
- ◎ **主な事業内容**
  1. 超砥粒砥石および人造研削砥石の製造ならびに販売
  2. 精密機械・半導体製造用機器および附属機器の製造ならびに販売
  3. 各種精密部品・工具・治具・ゲージの製造ならびに販売
  4. 電気機器・自動制御機器の製造ならびに販売
  5. 医療器具の製造ならびに販売
  6. タイルの製造ならびに販売
  7. 前各号に付帯する一切の事業
- ◎ **事業所**  
本社  
広島事業所（呉工場、桑畑工場、長谷工場）
- ◎ **国内拠点**  
大阪支店、九州支店、仙台営業所、名古屋営業所、諏訪営業所
- ◎ **海外拠点**  
DISCO HI-TEC AMERICA, INC.  
USA Head Office  
Eastern Regional Sales & Service Office  
Southeastern Regional Sales & Service Office  
Central Regional Sales & Service Office  
Southwestern Regional Sales & Service Office  
Northwest Regional Sales & Service Office  
DISCO HI-TEC EUROPE GmbH  
Europe Head Office  
DISCO HI-TEC FRANCE SARL  
DISCO HI-TEC UK LTD.  
DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE, LTD.  
South Asia Head Office  
DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD.  
DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD.  
DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
- ◎ **関連会社**  
株式会社ディスコ エンジニアリング サービス、株式会社ディスコ アプレイシブ システムズ、株式会社テクニスコ  
株式会社ディーエスディー、株式会社ダステック  
DD DIAMOND CORPORATION、S.E.A. UTENSILI DIAMANTATI S.p.A、  
DISCO-SEA AMERICA, INC.、DISCO-SEA EUROPE S.r.l.

代表取締役会長	関家 憲一
代表取締役社長	溝呂木 斉
取締役	中山 勉
取締役	関家 英之
取締役	梶山 啓一
取締役	溝呂木隆夫
取締役	田村 隆夫
取締役	関家 圭三
取締役	関家 一馬
常勤監査役	玉利 晋
常勤監査役	川崎 芳孝
監査役	瀧島 正和
監査役	木谷 孟

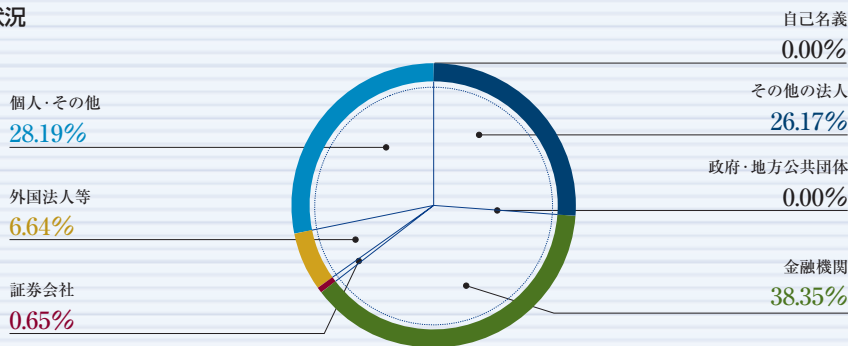
(平成14年6月27日現在)

# 株式概要

(平成14年3月31日現在)

上場証券取引所	東京証券取引所 市場第一部(証券コード 6146)					
発行済株式総数	32,117,125株					
株主数	12,617名					
大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行	3,349千株	10.43%	UFJ信託銀行株式会社	1,404千株	4.37%
	株式会社ダイイチ企業	1,998千株	6.22%	三菱信託銀行株式会社	1,331千株	4.14%
	株式会社ダイイチホールディングス	1,998千株	6.22%	関家 憲一	1,066千株	3.32%
	株式会社第一総業	1,749千株	5.45%	野村信託銀行株式会社	1,046千株	3.26%
	関家 臣二	1,434千株	4.46%	株式会社UFJ銀行	943千株	2.94%

## 所有者別分布状況



## 株価チャート



※平成12年3月28日に1:1.5の分割に伴う権利落ちがありました。

株 主 へ

決 算 期  
定 時 株 主 総 会  
利益配当金受領株主確定日  
中間配当金受領株主確定日  
名 義 書 換 代 理 人

同 事 務 取 扱 所

同 取 次 所  
公 告 掲 載 新 聞

(お知らせ)

名義書換代理人 東洋信託銀行株式会社は、平成14年1月15日付で商号変更し、UFJ信託銀行株式会社となりました。

モ

毎年3月31日  
毎年6月  
毎年3月31日  
毎年9月30日  
東京都千代田区丸の内一丁目4番3号  
UFJ信託銀行株式会社  
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号  
UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
TEL(03)5683-5111 (代表)  
UFJ信託銀行 全国各支店  
日本経済新聞

Visit Us!



ホームページアドレス  
<http://www.disco.co.jp/>



(お知らせ)

当社は今期より、貸借対照表ならびに損益計算書を当社のホームページに掲載することとしましたので、こちらでもご覧になれます。



DISCO CORPORATION